

X線観察 オンライン立会サービス



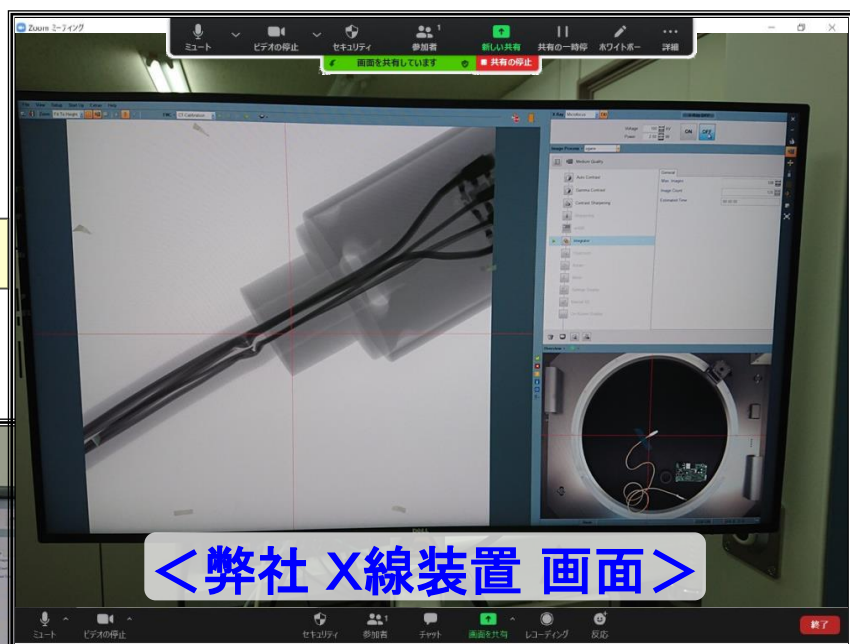
新型コロナウイルス感染予防対策での新しい働き方のスタイルとして、**オンライン立会サービス**を開始しました。
お客様と弊社ラボを**Web会議システム**で繋ぎ、まるで実際にその場にいる感覚でX線観察に立会えます。



感染予防と、移動の効率を図り、弊社技術者と対話しながらの作業により、狙いポントを的確に導けます。

装置は業界トップメーカー **YXLON**社の最新高分解能 X線CT装置 **Cheetah EVO**

Web会議システムは **webex** を標準とし **zoom** での対応も可能です。
※事前打合せもオンライン可能



例: 画面は、はめ込みです。

	Cheetah EVO
X線源	160kV/1mA
分解能	<0.3 μ m
検出器	FPD: 16bit
カメラ	100万画素
倍率	2,240倍
直交CT	200mm × φ 150mm
試料台	460mm × 410mm

観察後は、撮影画像の画面共有にて技術者とレビューが可能です。



実装基板・各種電子部品・半導体デバイス
 など、X線観察以外も各種試験に幅広く対
 応します。お気軽に問合せを！



名称	メーカー・形式	台数	仕様
実体顕微鏡	ライカ Z16 APO	1	観察倍率: ×3.6~×230 撮影装置: デジタル高精細画像・電子ファイル形式
	オリンパス SZH10	1	観察倍率: ×3.5~×140
金属・透過型顕微鏡	ニコンエクリアス LV100D・ME600L	3	観察倍率: ×25~×1500 撮影装置: デジタル高精細画像・電子ファイル形式
	オリンパス BX60MF5	1	観察倍率: ×37.5~×990 撮影装置: デジタル高精細画像・電子ファイル形式
デジタルマイクロスコープ	キーエンス VHX-6000	1	観察倍率: ×0.1~×2000 撮影装置: デジタル高精細画像・電子ファイル形式 傾斜角度: ±90度
測定顕微鏡	オリンパス STM-MJS	1	観察倍率: ×50~×800・最少0.5μmのX-Y-Z測長が可能
マルチフォーカス X線CT装置	エクスロン・インターナショナル Cheetah EVO	1	透視観察: ナノ・マイクロ・ハイパワー CTスキャン: 直行+斜めCT搭載 観察倍率: ~×3000 焦点寸法: 最小0.3μm 管電圧: 最大160kV 管電流: 最大1mA 撮像素子: FPD 16bit 100万画素 ステージサイズ: 460×410mm サンプル重量: 最大5kg
マイクロフォーカス X線装置	島津製作所 SMX-160LT	1	観察倍率: ×5~×2700 焦点寸法: 最小0.4μm 管電圧: 最大160kV 管電流: 最大0.3mA 撮像素子: I-I管 8bit 40万画素 ステージサイズ: 350×300mm サンプル重量: 最大2kg
超音波探査映像装置(SAT)	日立建機ファインテック HYE-FOCUS II	1	走査範囲: 340×340×50mm 最大倍率: 1000倍 最小走査ピッチ: 0.5μm 256表示階調 プローブ: 25,50,75,140,230MHz
レーザーパッケージ開封装置	Laser Decap PRO	1	レーザー方式: Nd:YVO4レーザー 波長: 1,064nm 定格出力: >9W パルス周波数: 0~200kHz 加工範囲: 200×200mm
パッケージオープナー(自動開封装置)	日本サイエンティフィック PA-103	1	使用薬品: 発煙硝酸 開封可能パッケージ: プラスチックモールド 開封温度50°C~80°C 時間設定: 0~59分59秒
試料切断装置	リファインテックRCA-005	4	ダイヤモンド切断ホイールΦ5インチ使用
	BUEHLERアイソメット2000	1	ダイヤモンド切断ホイールΦ6インチ使用
試料研磨装置	ALLIED マルチプレップ6	2	研磨ディスク: 12インチ 回転数: 10~350rpmで5rpm毎に可変
	BUEHLERアイコメット4000	2	研磨ディスク: 12インチ 回転数: 10~500rpmで10rpm毎に可変
	BUEHLERアイコメットツイン	1	研磨ディスク: 8インチ 回転数: 10~350rpmで10rpm毎に可変
	ホリスシステムPS-2000	2	研磨ディスク: 200mm 回転数: 10~200rpm無断変速
	丸本ストルアス ロボール25	1	研磨ディスク: 250mm/2枚 回転数: 40~600rpmで無断変速
クロスセクションポリッシャ	JEOL SM-09020CP II	1	イオン加速電圧: 2~6V イオンビーム径: 500μm(半値幅) 最大搭載試料サイズ/ミリングスピード CP: 幅11mm×長さ10mm×厚さ2mm/100um/H ミリング: 幅20mm×長さ20mm×厚さ3mm/4um/H
ディンプルグラインダー	GATAN Model656	1	初期試料厚さ: 200μm以下 最終試料厚さ: 5~10μm 研磨ホイール径: 15mmφ 研磨ホイール速度: 0~600rpm
電界放出(放射)走査型電子顕微鏡(FE-SEM)	日立 SU8000	1	【SEM】: 二次電子像分解能: 1.0nm・加速電圧: 0.1kV~30kV 倍率: ×30~×800,000・試料サイズ: Φ100mm SE(二次電子)・BSE-H(組成情報)・BSE-L(組成+凹凸情報)
	HORIBA EMAX x-act250	1	【EDX】: 検出元素範囲: B(5)~U(92) 検出器: シリコン・リチウム・ドリフト型・分解能: 137ev以下 その他: 定性分析、カラーマッピング機能、
走査型電子顕微鏡(SEM)	日立 SEMEDX III	1	【SEM】: 二次電子像分解能: 3.0nm(高真空25kV)、15nm(低真空3kV) 反射電子像分解能: 4.0nm 倍率: ×5~×300,000 試料サイズ: Φ150mm 【EDX】: 検出元素範囲: B(5)~U(92) 検出器: シリコン・リチウム・ドリフト型 分解能: 138ev以下 その他: 定性分析、カラーマッピング機能
ドライエッチング装置	日本サイエンティフィック ES373	1	高周波出力: 20~100W 電極間距離: 30mm シーケンス動作: 全自動 使用真空度: 5~80Pa プロセスガス: CF4, O2, 他 ステージ温度範囲: 30°C~50°C エッチング時間: 0~99min59sec
ボンドテスター	ザイズテック CondorSigma	1	ボンディングワイヤ(Au・Cu・Al) プル・シェアテスト対応 ロードセル: 100gf, 10kgf 測定誤差: ±0.075%
プログラマブルカーブトレーサ	テクトロクス 370B	1	ステップ・セネレーター機能搭載 最大ピーク電力 220W, 電圧2000V, 電流10A
PIND試験装置	B&Wエンジニアリング BW-LPD-DAQ4000	1	周波数: 40Hz(27Hz)~260Hz 加速度: 0~20G 衝撃: 1000±200G トランスジェンサ: 感度-77.5±3dB ステージ: 2インチ
卓上型精密万能試験機	島津製作所 オートグラフAGS-5kNX	1	負荷容量: 5kN 試験力測定精度: ±1%以内 クロスヘッド(引張ストローク): 1200mm(885mm) 試験空間(テーブル面): 幅420mm×奥行(無限)

内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部

213-0011 川崎市高津区久本3-9-25

TEL: 044-811-5496 FAX: 044-850-5851 <https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>

FAPR-025-02